

VECTECH 4500

BGA 紅外線返修系統

BGA / SMD Rework System

大型伺服板・高精度・高效率

適用於高階電子產品之 BGA / SMD

返修與焊接需求

The ideal solution for BGA / SMD rework and soldering in high-end electronics manufacturing.



PRECISION
RELIABILITY
HIGHER VALUE



高功率加熱系統

18,000W

- 頂部IR熱風混合+底部熱風加熱
- 大面積紅外預熱
- 多段溫控，提升溫度穩定性



大面積預熱

910×650 mm

- 適用大型 PCB 返修
- 降低大型板件熱應力
- 提升焊接製程穩定性



精密光學對位

±0.01 mm

- PL 精密對位系統
- 上下攝影機輔助對位
- 影像比對，提升晶片置放精度



RPC 焊接監控

RPC

- 即時觀察焊接溶錫狀態
- 即時掌握焊接製程
- 協助判斷焊接品質
- 製程資料可記錄與管理

應用範圍

APPLICATIONS

適用於各類高階電子產品之 BGA / SMD 返修和焊接需求

Suitable for BGA / SMD rework and soldering in a wide range of high-end electronic products.



01 伺服器主機板

大型PCB

Server Motherboards
Large PCB



02 工業控制 PCB

工業/自動化設備

Industrial Control PCB
Industrial Automation



03 AI / 高階運算板

高密度BGA/高階運算

AI / High-Performance Computing
High-Density BGA



04 通訊設備主機板

網通/基地台設備

Telecommunication Boards
Networking / Base Station



05 車用電子控制單元

車用ECU/電子控制

Automotive Electronic Units
Automotive ECU



06 大型電子組裝板

大型模組/電子組裝

Large Electronic Assemblies
Large Format PCB

主要規格

/SPECIFICATIONS

項目	協調規格
IR 紅外加熱總功率	Max. 18.000 W
電源	AC 380 V ±10%. 50/60 Hz
頂部熱風加熱功率	1,600 W
底部熱風加熱功率	1,100 W
底部紅外預熱功率	14,000 W
最大 PCB 尺寸	950 × 750 mm

項目	規格
最大預熱面積	910 × 650 mm
最大晶片尺寸	80 × 80 mm (菱鏡可移動至 120 × 120 mm)
上部發熱器尺寸	120 × 120 mm
對位精度	±0.01 mm
外接 K 型感測器	6 通道
設備行程 X / Y / Z	1,200 / 900 / 180 mm
外形尺寸 L × W × H	2,000 × 1,620 × 1,600 mm
總淨重	約 600 kg

